

Klebstoffe

hochtemperaturstabil

Produktübersicht und -vergleich



Thixotrop
Hochtemperaturbeständig
Chemikalien-/Lösungsmittelresistent
Geringe Wasser-/Dampfaufnahme
Hochhaftend

Bezeichnung	Basis-System	Übliche Anwendung						Farbgebung	Viskosität	Misch.-verh. /Topfzeit	Zugscher- festigkeit	Wärmeform- beständigkeit	Shore- Härte A	Aushärtung
			Thixotrop	Hochtemperaturbeständig	Chemikalien-/Lösungsmittelresistent	Geringe Wasser-/Dampfaufnahme	Hochhaftend							
SurABond® SK 250 S	1-komponenten Epoxidklebstoff	für die thermo-/mechanisch stabile sowie klima-, feuchte- und chemikalienbeständige Verklebung von keramischen Bauteilen untereinander sowie mit Metallen und Glas		x	x	x	x	Weiß (bzw. Schwarz)	gefüllt	-	~ 30 N/mm ²	bis +250 °C , kurzzeitig +300 °C	-	Thermischhärtend, 1 Std. bei 180 °C, alternativ 30 min. bei 200 °C
SurABond® SK 310	1-komponenten Epoxidklebstoff	für die Verklebung von mikroelektronischen Bauteilen, insbesondere von solchen, die bei erhöhten Einsatztemperaturen sowie unter Klimabelastungen arbeiten	x	x	x	x	x	Weiß	gefüllt	-	~ 44 N/mm ²	-40 °C bis +250 °C kurzzeitig +300 °C	-	Thermischhärtend 1 Std. bei 180 °C, alternativ 30 min. bei 200 °C
SurABond® HG 310	1-komponenten Epoxidklebstoff	für die Verklebung von mikroelektronischen Bauteilen, insbesondere von solchen, die bei erhöhten Einsatztemperaturen sowie unter Klimabelastungen arbeiten	x	x	x	x	x	Rotbraun	-	-	-	-40 °C bis +250 °C kurzzeitig +300 °C	-	Thermischhärtend 1 Std. bei 200 °C